

廣運機械 法人說明會

2026.8.19

上櫃 6125

報告大綱

PART 01

公司簡介及財務資訊

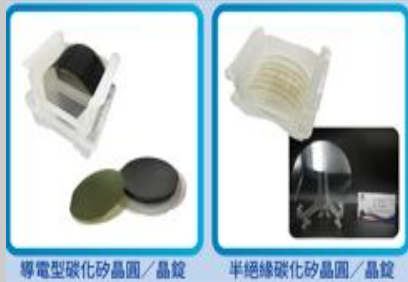
PART 02

公司產品與實績

PART 01

公司簡介及財務資訊

廣運合併報表**主要個體公司**

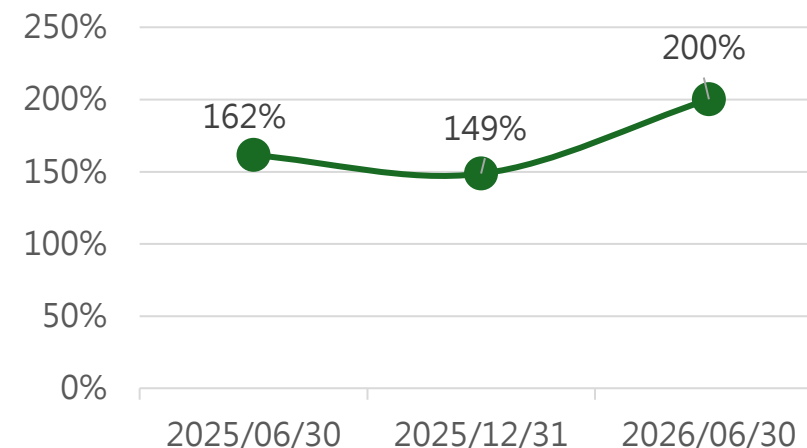
公司 / 代號	資本額(億)	主要產品
廣運 6125  成立時間 1976年7月 股票上櫃 2002年1月	25.9	智慧製造-智慧物流 半導體物流OHT / AMR 公共工程 虛實整合Digital Twin AI產品代理 
太極 4934  成立時間 2007年5月 股票上市 2011年8月 廣運持27.2%	22.5	太極:太陽能電池片、 充電樁 永暘:矽水膠隱形眼鏡 
盛新 6930  成立時間2020年6月 股票公發2022年10月 (前身為2018年太極SiC事業群) 太極持32.89%、廣運持10.66%	9.0	第三類半導體 碳化矽(SiC)長晶 N型-導電型:車載 Si型-半絕緣型: 散熱、 半導體、通訊基建 
金運  成立時間2010年2月 預計申請與櫃併送公發 2026年Q4 (前身為2001年廣運電子事業群) 廣運持71.59%、太極持3.476%	6.6	熱管理事業 電子代工服務 

廣運合併資產負債表

單位:新台幣億元

會計科目	2026年 6月30日	2025年 12月31日	2025年 6月30日
流動資產	55.91	51.07	47.18
非流動資產	68.51	66.57	64.97
資產總計	124.42	117.64	112.15
流動負債	27.94	34.33	29.19
非流動負債	29.70	25.39	25.69
負債總計	57.64	59.72	54.88
普通股股本	25.90	25.90	25.90
資本公積	14.23	12.48	12.50
保留盈餘	8.15	8.03	7.63
其他權益	(1.67)	(2.08)	(3.21)
股東權益(屬母公司)	46.61	44.33	42.83
股東權益(含少數股權)	66.78	57.92	57.27
負債比率	46%	51%	49%
流動比率	200%	149%	162%
每股淨值(元)	18.00	17.12	16.53

流動比率



廣運合併損益表

單位:新台幣億元

會計科目	A.2026年H1		B.2025年H1		C=增加金額 A-B 成長%=C/B	
營業收入	18.59	100%	13.31	100%	5.27	40%
營業毛利	4.20	22%	2.62	20%	1.58	60%
營業淨利	(1.80)	10%	(2.59)	19%	0.79	31%
稅前淨利	(0.98)	(5%)	(1.72)	(13%)	0.74	43%
稅後淨利	(1.03)	(5%)	(1.75)	(13%)	0.72	41%
稅後淨(損)利-歸屬於 母公司	0.38	2%	(0.12)	(1%)	0.50	432%
基本每股盈餘(元)	0.15		(0.04)			

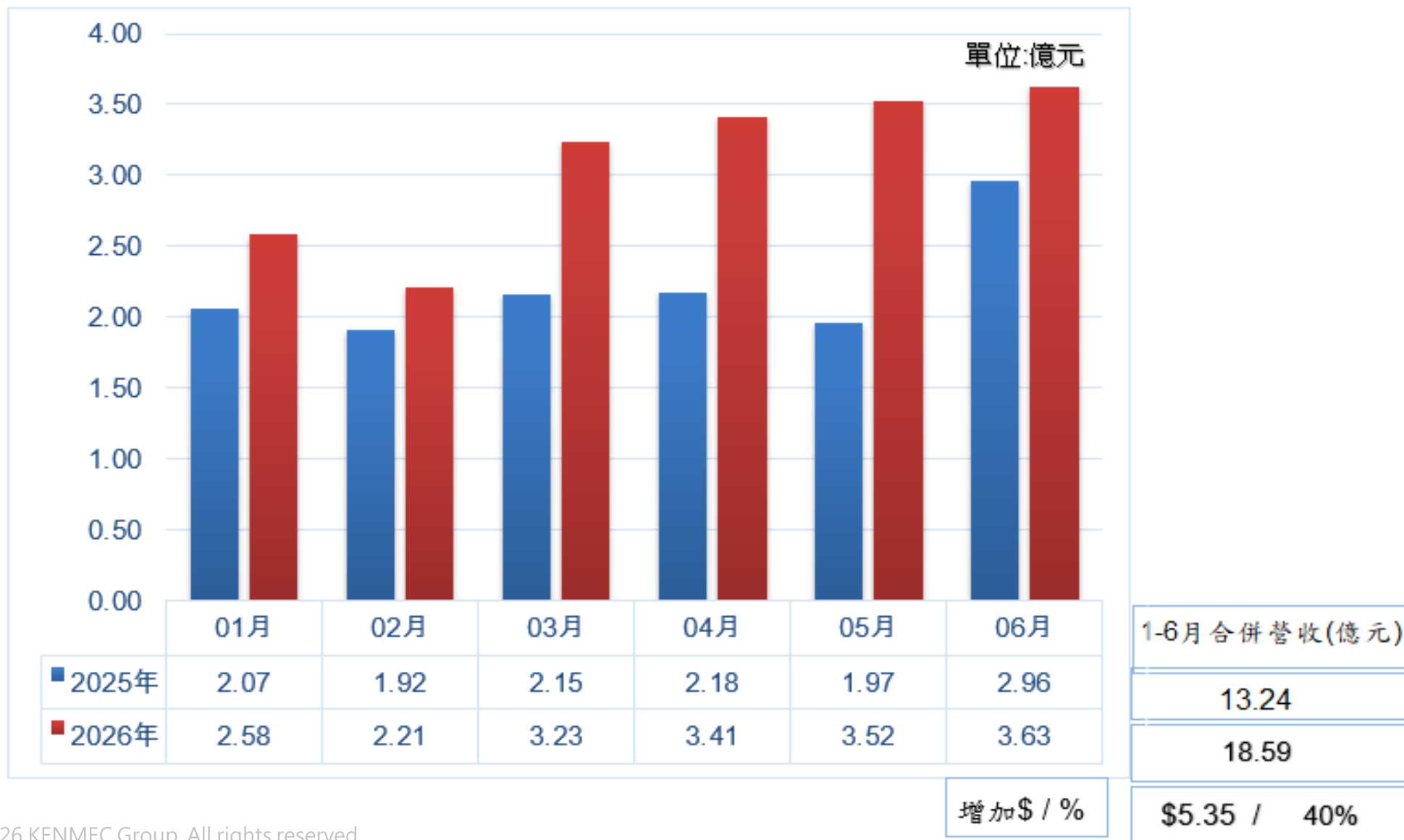
廣運合併現金流量表

單位:新台幣億元

會計科目	2026年H1	2025年度	2025年H1
營業活動之現金流量	(3.34)	2.79	0.36
投資活動之現金流量	1.23	(3.90)	(0.62)
籌資活動之現金流量	9.38	(2.99)	(3.06)
匯率變動對現金及約當現金之影響	0.08	0.12	(0.11)
現金及約當現金淨增加(減少)	7.34	(3.98)	(3.43)
期初現金及約當現金餘額	19.82	23.80	23.80
期末現金及約當現金餘額	27.16	19.82	20.37

廣運合併營收比較

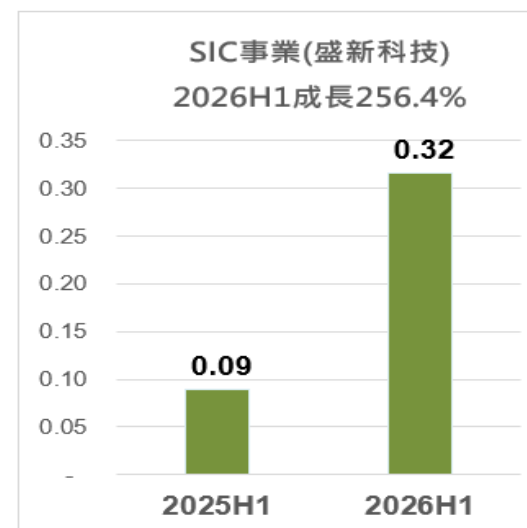
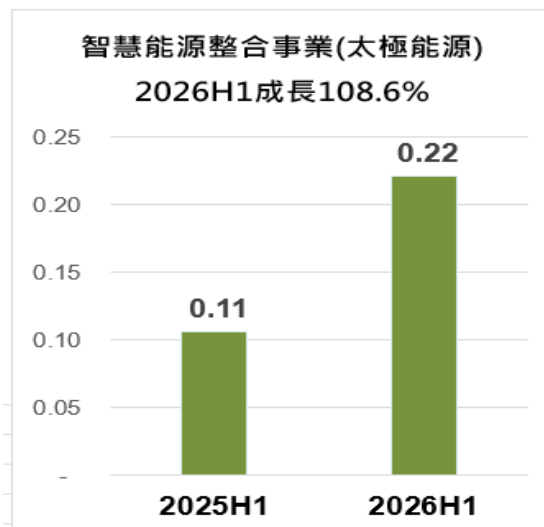
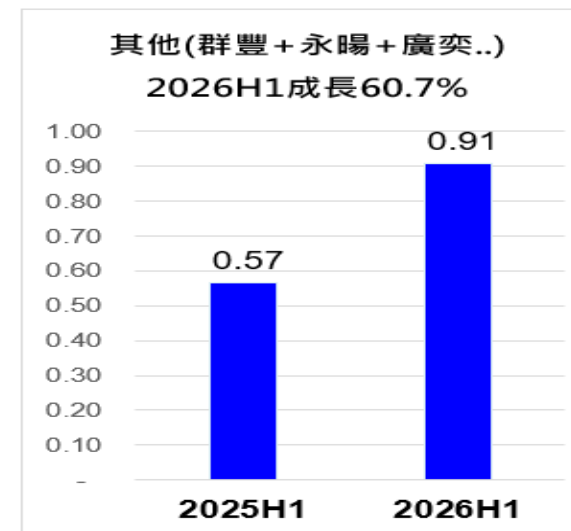
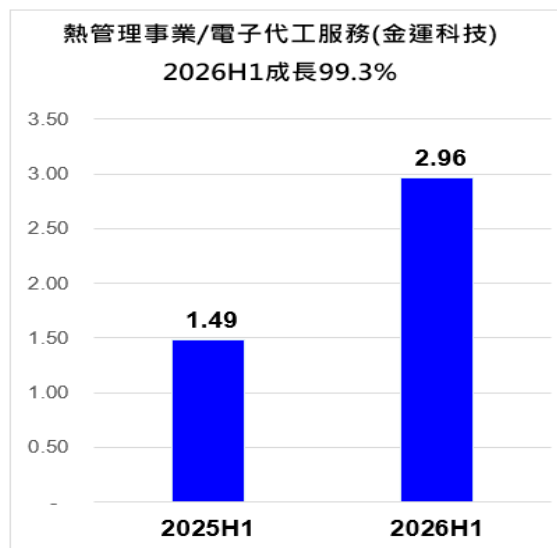
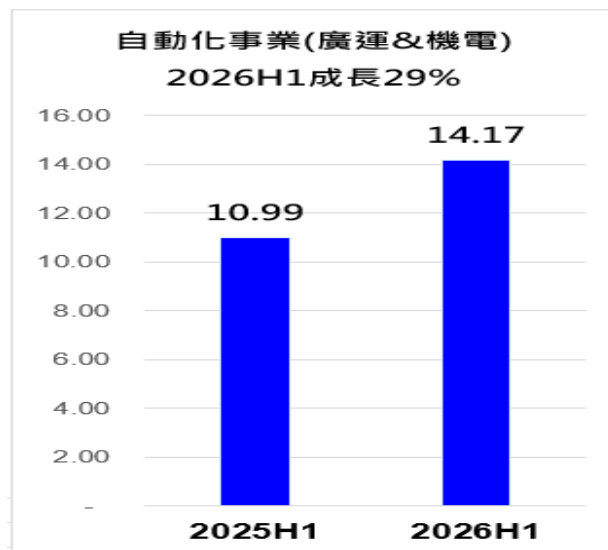
2026H1 VS 2025H1



廣運合併營收比較-by事業體系

2026H1 VS 2025H1

單位:新台幣億元



PART 02

公司產品與實績

公司定位與願景

定位

智慧製造與智慧物流系統整合領導者

- 深耕：智慧製造及物流系統、公共工程及機電整合、半導體物流、AI產品代理、Digital Twin
- 延伸：能源、半導體、AI應用
- 目標：成為「AI驅動的工業解決方案平台」

願景

建構「虛實整合（Digital Twin）」的產業新模式

從設備、系統到工業場域，形成可視、可預測、可優化的閉環。

核心競爭力

三大維度建構產業護城河



系統整合能力

- 從設備 → 系統 → 整體解決方案
- 擅長跨設備、跨流程的整體導入



跨產業整合能力

- 半導體 × 能源 × AI × 製造
- 以集團事業體形成互補能力



技術能力

- AI / Digital Twin / 自動化控制
- 支撐預測、排程、維護與最佳化

由底層設備能力出發，向系統整合、跨域協同與 AI 軟體能力疊加。

AI 驅動的一站式智慧整合服務



五大方向

與客戶共同成長

智慧製造
智慧物流



半導體物流
OHT / AMR



公共工程



虛實整合
Digital Twin



AI產品代理



NVIDIA SP

NVIDIA Partner Network - Solution Provider (SP) Program

以 Digital Twin 提升規劃、模擬與驗證效率

先在虛擬環境看見問題、再比較方案、驗證最佳解

- 將設備、建立設備、產線與場域數位模型
- 比較配置、動線與作業邏輯
- 提前發現瓶頸與潛在衝突
- 提升規劃品質與決策精準度



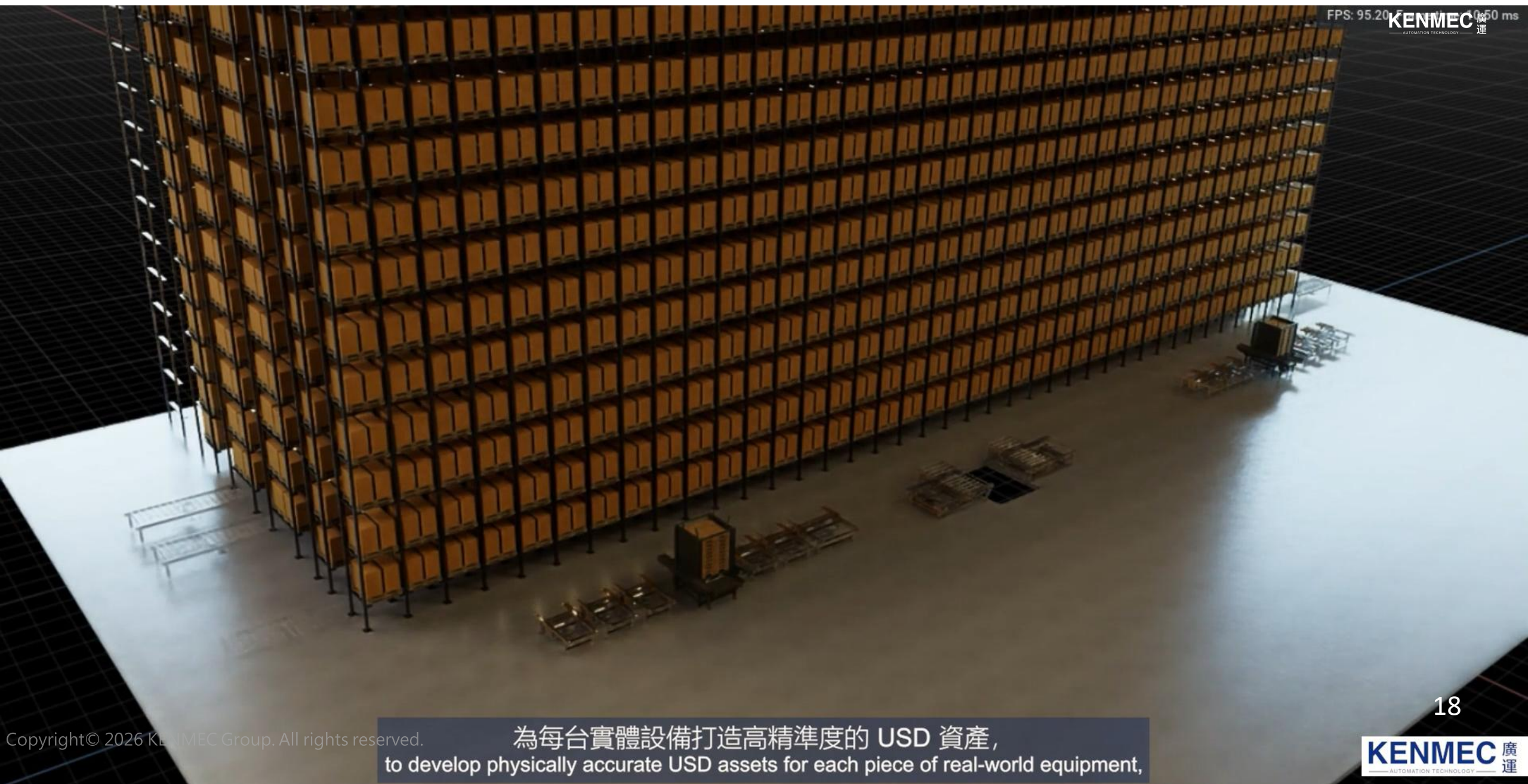
Digital Twin 讓規劃更有依據、驗證更完整、決策更精準。

數位孿生

-智慧物流中心

Features

- 模擬不同組合的最佳解
- 現有場域的優化及效率提升
- 擴建場域的參考基礎



數位孿生

-半導體產線應用

Features

- 撰寫 OHT 訓練環境，讓自動天車在 Omniverse 中模擬。
- 透過大量數據進行 deep learning AI 訓練，尋找最佳解。



數位孿生

- 行李輸送模擬應用

Features

1. 行李輸送模擬環境建立
2. 驗證流程動線與設備配置
3. 支援方案優化與擴充評估
4. 強化導入前的可視化溝通



廣運國產化智慧鐵道

□ 數位孿生



□ 集電弓



□ 列車門



□ 智慧CCTV & AI車廂

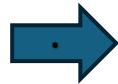
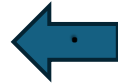


□ VPSD月台門

2026鐵道聯展邁向世界



廣運國產智慧列車展 瑞芳廠
15-16 APR 2026 · NEW TAIPEI



台北自動化大展 N814
19-22 AUG 2026 · TAIPEI

Ugo Pro – 全功能旗艦款

雙臂設計，可執行按電梯，開門、儀表辨識等複雜動作。

- **跨樓層運行**：可搭配電梯使用，一台機器可支援多樓層
- **多元應用**：適合智慧巡檢、服務與高互動需求的場域
- **彈性擴充**：支援感測器模組擴充，具備高適應性
- **自由移動**：可調整高度的機身、全方位移動底盤



虛實整合 Digital Twin

支援廣運多元應用落地的關鍵能力

三大核心能力建構：

- Omniverse / OpenUSD 應用能力
- IT / OT 資料整合能力
- Simulation 與驗證能力

Digital Twin
有助於提升規劃、驗證與營運優化效率



以 Digital Twin 核心平台，串聯廣運四大應用場域

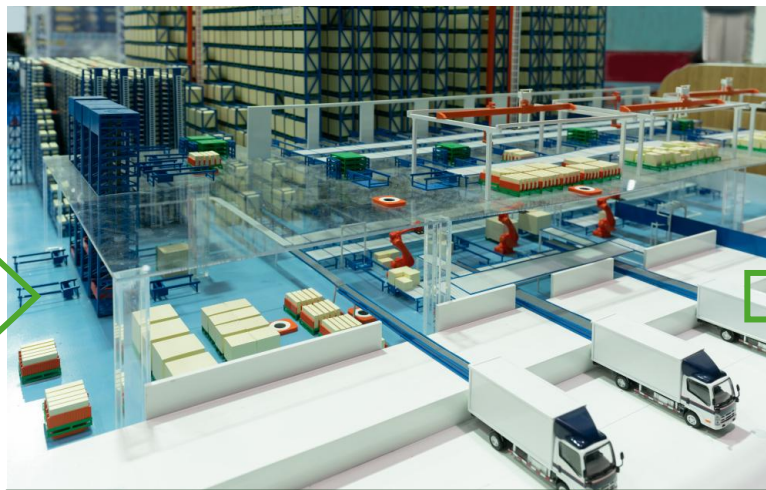


**以 Digital Twin 為核心能力底座，支援智慧製造、半導體物流、公共工程與 AI 應用整合。

從「設備整合」轉型為「AI 解決方案整合夥伴」



Past : Conveyor



Now : System Integration

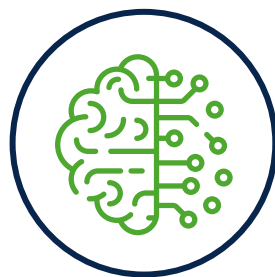


Future : AI Solution Partner



選對

嚴選全球頂尖技術，
提供最適化配置



用好

結合Nvidia
Omniverse，虛實整合
驗證，將AI轉化為現場
生產力



用久

提供全生命週期維運，
確保長期效益

海外布局

全球市場拓展策略

東南亞

智慧工廠與物流需求快速成長

美國

半導體供應鏈機會

以系統輸出為主軸，複製智慧製造與智慧物流整體解決方案

輸出整體解決方案 (System Export)

